

特点:

- 输出功率典型值: +7dBm
- 相位噪声: -95dBc/Hz @10kHz
- 工作温度: -45~+85°C
- SMT 封装
- 封装尺寸: 19.1×13.1×5.5(max)mm³
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=25°C)

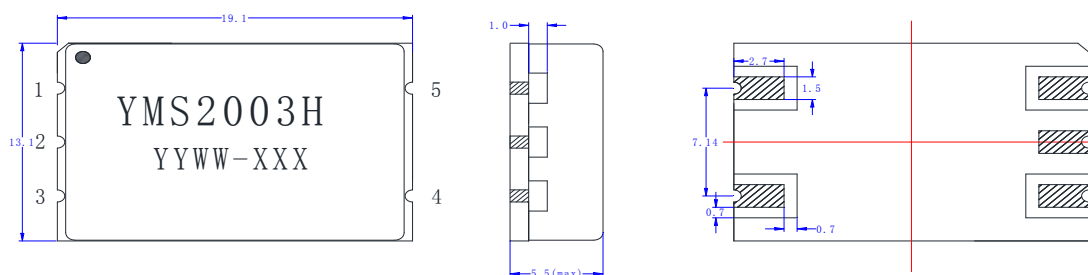
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
输出频率	F _{OUT}	工作电压: 5V (相噪测试: @10KHz)		890		MHz	全温
频率准确度	Δf				±20	ppm	
频率稳定度					±100	ppm	全温
输出功率	P _{OUT}		6	7		dBm	全温
二次谐波抑制			50	60		dBc	
杂波抑制				60		dBc	
相位噪声	PN				-95	dBc/Hz	全温
电源电压	V _S		+4.5	+5	+5.5	V	全温
电源电流	I _S			130	200	mA	
工作温度			-45		+85	°C	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压 V _S	+6	V	贮存温度	-55~+100	°C

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm


字符标志:

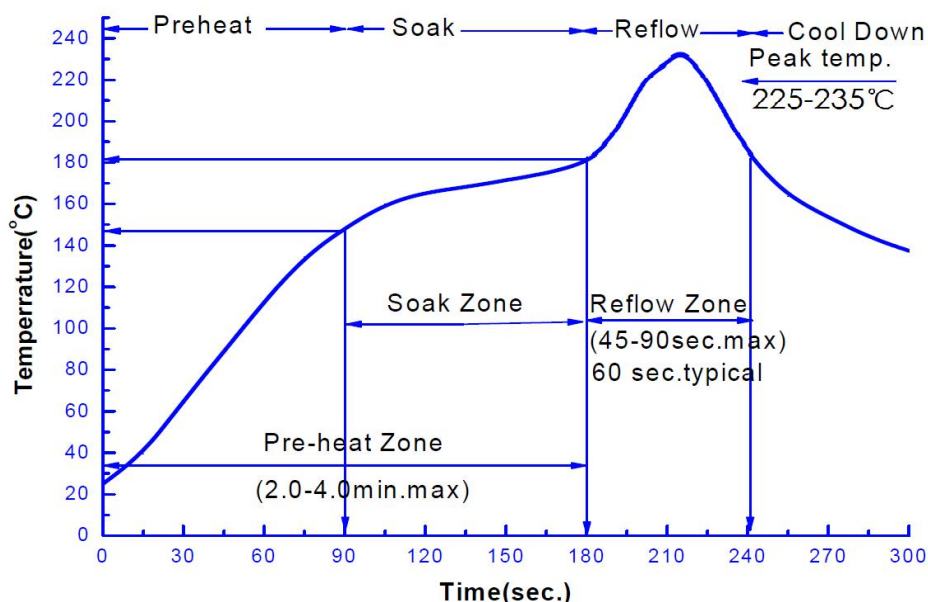
YMS2003H	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

引脚	符号	定义
1	+5V	电源供电端
2	GND	电源地
3	NC	悬空
4	NC	悬空
5	RF OUT	射频输出端

产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 印制板和屏蔽罩组合式的产品属于非密封器件，客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，保证产品上的缝隙及输入/输出孔口完全被覆盖，以提高产品耐环境适应性能力。